

# 板簧失效分析，达克罗盐雾试验白锈

产品名称	板簧失效分析，达克罗盐雾试验白锈
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

## 产品详情

### 板簧失效分析，达克罗盐雾试验白锈

失效分析（FA）是对已失效器件进行的一种事后检查。根据需要，采用电测试以及各种先进的物理、金相和化学分析技术，并结合元器件失效前后的具体情况及有关技术文件进行分析，以验证所报告的失效，确定元器件的失效模式、失效机理和造成失效的原因。全面系统的失效分析可以确定失效的原因，对于器件设计、制造工艺、试验或应用的改进具有指导作用，采取相应的纠正措施消除失效模式或机理产生的原因，从而实现器件以及装备整体可靠性的提高。

通过失效分析可以发现失效器件的固有质量问题，也有可能发现元器件因不按规定条件使用而失效的使用质量问题，通过向有关方面反馈，促使责任方采取纠正措施，以便消除所报告的失效模式或机理产生的原因，防止其再次出现，对提高元器件的固有质量或使用质量都起到十分重要的作用。

失效分析对产品的生产和使用都具有重要的意义，失效可能发生在产品寿命周期的各个阶段，涉及产品的研发设计、来料检验、加工组装、测试筛选、客户端使用等各个环节，通过分析工艺废次品、早期失效、试验失效、中试失效以及现场失效的样品，确认失效模式、分析失效机理，明确失效原因，\*终给出预防对策，减少或避免失效的再次发生。

### 分析项目

#### 基本项目

- 1、外部检查
- 2、电参数测试
- 3、非功能测试
- 4、X射线照相X-RAY、X-CT 射线分析（3D）

- 5、PIND
- 6、密封性检查
- 7、声学扫描显微镜分析(SAM) C-SAM、TEM (透射电子显微镜)
- 8、内部检查
- 9、剖面金相分析
- 10、键合强度测试
- 11、剪切强度测试
- 12、扫描电子显微镜分析(SEM)、SEM&EDS
- 13、粗检漏、细检漏
- 14、内部气氛分析仪
- 15、切片
- 16、染色试验
- 17、FIB (聚焦离子束)
- 18、ESD测试
- 19、Latch-up 测试 (电源端)
- 20、芯片剪切力、键合拉力、推球
- 21、EMMI (光发射显微镜)
- 22、红外热成像系统
- 23、TOF-SIMS (二次离子质谱分析)

形貌分析技术：体视显微镜、金相显微镜、X射线透视、声学扫描显微镜、扫描电镜、透射电镜、聚焦离子束

成分检测技术：X射线能谱EDX、俄歇能谱AES、二次离子质谱SIMS、光谱、色谱、质谱

电分析技术：I-V曲线、半导体参数、LCR参数、集成电路参数、频谱分析、ESD参数、电子探针、机械探针、绝缘耐压、继电器特性

开封制样技术：化学开封、机械开封、等离子刻蚀、反应离子刻蚀、化学腐蚀、切片

缺陷定位技术：液晶热点、红外热像、电压衬度、光发射显微像、OBIRCH

常见失效分析产品

PCBA、高光板、雨刮器、汽车线束、汽车面板、汽车导航、通信模块、LED、光模板